

株式会社アドバンテスト

2025年3月期(2024年度)第1四半期決算説明会 質疑応答要旨

2024年7月31日(水)

- Q1: 短期需要の強さを踏まえ、暦年2024年のテスト市場規模見通しを上方修正したが、第3期中期経営計画(MTP3)における暦年2025年、2026年の市場規模見通しに変化はあるか。また、製品ミックスの改善に伴い、利益率の見通しについても変化はあるか。
- A1: 暦年2025年以降のテスト市場規模見通しおよび利益率の見通しについては、変動要因が多いので量的にお答えすることは難しい。しかしながら、足元ではアップサイクルに入っているとみており、今後1年以上は市場の成長が見込めるのではないかとみている。当社が良好な市場ポジションを獲得している領域で市場の成長が見込める環境にあり、収益性が高いHPC向けのSoCテスト需要の伸びを見込むことや、HBMの技術進化に伴ったソリューションを投入していくことで、収益性を向上させていきたい。
- Q2: 御社はファブレス、ファウンドリでのおおよその生産見通しに対して、テストの需要を推量していると思う。通期業績予想の上方修正分について、そのような顧客が生産するHPC/AI向け半導体、GPUなどの個数を鑑みた場合に、御社から見たら、顧客は強めに発注しているのか、まだ不足気味なのか、テストの引き合いの強弱をどのように感じているか。
- A2: 顧客のサプライチェーンにおいて、先端パッケージの組み立て能力がかなり増加してきたことで、生成AI向けのハイエンドなロジック・デバイスの生産数量を、急進に引き上げている。直近の1か月ほどで、顧客が実際に想定していたよりも入念な試験が必要であるということがわかった。
- また、これまでスマートフォン向けで落ちこんでいた台湾を中心とするOSAT顧客のテスト稼働率が、生成AIで採用されているV93000の最新のプラットフォームについては、現状ほぼフル稼働の状態に変わってきた。このような要素が重なり、今回上方修正を行った。
- このように、わずか1か月で状況が大きく変わる市場にいる中では、今後の見通しがどのように変化するか我々も想定することは非常に難しいのだが、前提としては、生産数量、テストタイム、稼働率などいろいろな需要変動の要素を考慮し、見通しをたてている。
- Q3: SoCテストの需要が高まっているAI用のプロセッサでは、向こう1年ほどはテストタイムの短縮は難しいと考えるか。
- A3: 半導体の複雑化が進展している中で、テストタイムの予測が困難であり、当社としても大きな課題と認識している。

一般論としては、新しい半導体を上市した後は、半導体メーカーはその半導体の製造プロセスを習熟させ、品質が安定するように努めていく。その結果、テストタイムは短縮される。そういった動きはこの先1年で起こるであろうと考える。しかし一方で、複雑性が増加しているGPUなどでは、ロードマップの進展が非常に早く、来年もまた新しい半導体が上市されていく。そういった短い開発サイクルが、テストタイムにどのような影響を及ぼすかは予測しづらい。

- Q4: 1QのSoC テスタ売上は約690億円と高い売上水準であったが、先ほどスマートフォン向けの需要はまだ不透明という説明もあった。通期2,920億円のSoC テスタ売上見通しにおける、2Q以降の推移とビジビリティはいかがか。
- A4: SoC テスタ需要は、テストタイムの長時間化、半導体のサプライチェーンにおける組立能力増強、テスト・サプライチェーンにおけるテスタ稼働率の上昇といった3つの良い要素が同時に起こっていることで強い商談をみている。2Q以降、もちろん想定外のリスクは常にあるが、今期のSoC テスタの売上予想を470億円上乘せしたというガイダンスに対しては自信を持っている。
- スマートフォン向けテスト需要は、現状生成AI関連向けと比べるとまだ小さい規模である。しかしながら、テスタ稼働率の上昇を踏まえると、AI機能を搭載したアプリケーション・プロセッサ向けの新規テスト需要が段々と活発になることが今後のテスト需要のアップサイドの可能性としてあげられる。
- Q5: 今期は2Q以降、全社売上がおおよそ横ばいで推移し、下期になるとHBM向け中心にメモリ・テスタの売上が増えることを踏まえると、SoC テスタの売上が下期にかけて若干下がっていくと推測する。現状のリードタイムが短いことで不透明感を考慮した慎重な売上予想になっているのか。
- A5: ご認識の通り、上期と下期で考えるとSoC テスタの売上は下期に少し下がると現時点では想定している。特に需要が落ち込む要因が見えているわけではないものの、下期に関してはまだ十分に見通せていない部分があるのが実態である。
- Q6: 3か月前と比べ、SoC テスタ売上の見通しを引き上げたのはテストタイムが長くなったことが最大の要因ということか。また6月末のMTP3発表時点では、このSoC テスタ需要の上振れを考慮した数値目標なのか。
- A6: テスタの需要に影響のある、先端パッケージの組立能力の増強や、量産拠点のテスタ稼働率の上昇はある程度当社も予想していた。しかしながら、テストタイムの予想以上の伸びは読み切れていなかった。顧客にとっても想定外であり、4月時点で当社の業績予想には織り込むことができなかった。半導体の複雑性が増す中、顧客は実際の生産立ち上げをする中で、その歩留まりの状況を把握しながらテストプログラム、テスト工程を調整し

ている。当社はこのような需要の大きな変化をここ1か月くらいで認識した。したがって、MTP3の数値目標には織り込んでいない。

Q7: 今期の上方修正を踏まえ、MTP3の3年平均の売上目標に対して、レンジの下限に落ち着く可能性は少なくなったか。

A7: 2025年度以降の見通しに関しては確固たる自信がまだない。2024年度としては非常に良いスタートとなったが、2025年度以降はしっかり顧客とコミュニケーションを図った上で、精査していく必要がある。

Q8: 今期のSoCテストの80%を構成すると想定しているコンピューティング・通信の領域に関して、そのアプリケーション別の内訳を教えてください。その中でも特にHPC/AI向けの領域での内訳で教えて欲しい。

また、下期にもしこの領域に上振れがあるとしたら、どのようなアプリケーションがけん引するのか。

A8: 今期に関しては、HPCといわれる中でもAIアクセラレータ向けのビジネスが非常に大きな比率として立ち上がっている状況。総体的には、そのビジネスが需要をけん引している。通信、モバイル向けのテスト需要に関しては、足元では未だに需要は顕著ではないが、今後のHPC/AIの社会実装の進展に伴い、最終需要において需要が少し戻ってくることを期待している。

テスト需要の上振れの可能性を考えると、AIの社会実装の進展において、パソコンを含め、その他多様なアプリケーションなどへのAIの浸透や、その領域で半導体を開発する新たなプレイヤーの市場参入などが、当社にとって追加のビジネス機会となりうるが、それらはまだ明確には見えていない。引き続き様々な顧客とコミュニケーションをとりながら、それらの内容をしっかり精査していきたい。

Q9: 上振れを期待している領域は、大きな範疇ではAIに関連する領域ということか。エッジAIはスマートフォンやPCなど様々あると思うが、結局、HPC/AIの領域が上振れする可能性があるという考え方か。

A9: はい。足元はデータセンタが事業のけん引役となっているが、エッジAIが広がる兆候が見えつつある。スマートフォンを含む民生機器の数量に鑑み、エッジAIの進展はアップサイドにつながる。データセンタに加えて、エッジAIが進展することで、中期的には成長が期待できる。

Q10: 御社の製品供給能力および売上高の上方弾力性について確認したい。今回の業績予想では、2Q以降は四半期ベースで売上1,500億円を超える生産キャパシティが必要に

なってくると推測される。このレベルが現状の生産キャパシティの上限となるのか。また、今後はどの程度の売上レベルまで対応できるのか。

A10: 当社の供給能力が具体的にいくらの上まで対応が可能か、定量的にはお答えできないが、顧客から長期フォーキャストを事前にいただきながら、今後も需要増に追従していく。現状は、メモリ・テストについては、HBM 向けを中心に顧客より長期フォーキャストをいただいております。当社はサプライヤーとともに増産体制を強化している。SoC テスタでは、HPC/AI 関連の半導体でテストタイムが長時間化していることから、顧客においてテストの確保が緊急な課題になっているが、当社はこれまで成長領域に向けて戦略的に部材調達を進めてきたことから、顧客要求にかなり対応することが可能となっている。

Q11: 収益性に関して、1Q の売上総利益率 55.4%というのは非常に大きく改善されていると思う。SoC テスタの売上が伸びたという製品ミックスの影響なのか、それとも HBM においても想定以上に収益性の改善を見ているのか。この背景を教えてください。
また、年間の売上総利益率が約 52%の見込みということで、おそらく 2Q 以降その率は少し下がるという前提になっていると思うが、そちらの背景も併せて教えてください。

A11: 1Q の売上総利益率が上がった理由は、大きく 2 つある。

1 点目は、製品ミックスが大きく改善したこと。ハイエンドの HPC 向け、AI サーバー向けの GPU、アクセラレーション・プロセッサ・ユニットが非常に好調に立ち上がっているという背景から、高性能・高機能な SoC テスタの売上計上が大きかった。

2 点目は、HBM に関して、より緻密にテストするために必要なアップグレードの要求が少しずつ増加しており、それも売上総利益率の改善に寄与した。今後、下期に向けてそのアップグレードの要求はさらに進むと見ている。

通年を通して売上総利益率がどのように推移していくかということでは、全体としての SoC テスタは今後も継続的に出荷が進むが、HBM に向けたメモリ・テストについては、製造キャパシティの改善とともに、その売上が下期に向かって増加していく。このような製品ミックスの変化から、2Q 以降の売上総利益率は少し下がることを想定している。

Q12: 今期の売上総利益率の計画が 48%程度から 52%程度と大きく引きあがった背景は、SoC テスタに占めるコンピューティング・通信および車載・産業機器・民生・DDIC の構成比が変動し、そのミックス改善が進んだ影響が最も大きいのか。

A12: SoC テスタ売上におけるコンピューティング・通信の構成比見通しを、今回約 80%と比率を上昇させている。中でも、テストの販売単価や収益性が高い HPC デバイス向けの売上寄与度が大きくなることで、今期の売上総利益率の引き上げに最も影響している。

Q13: HBM3E や HBM4 などへの移行を踏まえ、テストのアップグレードはいつ頃起きるのか？

- A13: 次世代 HBM に向けて、新たなソリューションを鋭意開発中である。メモリ顧客において当社は極めて強固なポジションをおさえているため、これらの次世代 HBM の上市スケジュールに合わせて、顧客と緊密に連携している。
- Q14: 今後、自社半導体を開発する企業がテスト市場の成長をけん引すると考えられる。これから新規顧客の需要の取り込みは今後 2 年くらいの時間軸でどのくらいの規模になると見込んでいるのか。競合も強いポジションを持っていると思うが、御社はどのようにシェアを確保しようとしているのか。
- A14: HPC/AI 関連の既存顧客に対しては、当社はすでに強固なポジションを持っているが、このような既成の半導体企業と、自社半導体を開発するハイパースケーラーなどの新興企業を区別することが重要である。また、企業数としてはまだ多くはないが、ハイパースケーラーのために ASIC を設計する企業も、今後重要性を増してくると認識している。いずれのケースにおいても当社はすでに良好なポジションにいる。目先 2 年程度の時間軸の中で、これらの顧客は我々にとっての成長ドライバーであり、今後 SoC 市場において一定の規模を占めるようになるだろう。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。